国际先进封装产业化技术论坛

**暨**“**第**六**届华进开放日**”**活动参会报名表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称  Unit |  | | | | | | |
| 地 址  Address |  | | | | | 邮 编  zip code |  |
| 经营范围  Scope of business |  | | | | | 参会  总人数 | 共 人 |
| 参会代表  Name | 职务  Title | 性别Gender | 联系手机  Cellphone | 是否需要预定酒店  Book hotel for you  (Yes/No) | 入住日期  Check-in  Date | 退房日期  Check-out Date | 是否参加  27日晚宴  (Yes/No) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 会议  联系人 |  | 电话 |  | 传真 |  | 邮箱 |  |
| **如有其它需求,请说明:** | | | | | | | |

**（注：本表复印有效，请完整填写后邮件给我们，谢谢！）**

**报名咨询热线：**

**华进半导体封装先导技术研发中心有限公司--战略研究与产业化部**

孙绪燕 Tel：151 6167 1816， 0510-6667 9351， Email：[xuyansun@ncap-cn.com](file:///C:\Users\chaoxu\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\KTF3MD8P\xuyansun@ncap-cn.com)